



Agency Contact:

David Moreno

MCA

Tel: +1-650-968-8900, ext. 125

E-mail: dmoreno@mcapr.com

**SPIE BACUS PHOTOMASK TECHNOLOGY SYMPOSIUM 2012にてEBeam INITIATIVEメンバーが
パートナーシップの結果を発表**

eBeam Initiative ロードマップに従い、20nm 世代以降のマスク品質とマスクコストへの要求に応える
進捗を BACUS にて提示する

SAN JOSE, Calif., September 4, 2012-電子ビーム (eBeam) 技術を利用した半導体製造の新技术の普及と促進を目的したフォーラムである eBeam Initiative は、本日、その複数のメンバー企業がマスク技術における最新の eBeam ブレークスルーの数々を [SPIE/BACUS Photomask Technology Symposium](#) にて発表する予定であるとアナウンスを行った。パートナーシップにより、20nm 世代以降のマスク精度の改善と描画時間の改善のための技術開発、および、マスクコスト曲線を下げするための技術開発にて、半導体 eBeam エコシステムを醸成するために本年初頭に開示された [eBeam Initiative ロードマップ](#) に示された主要マイルストーンを達成する、大きな進捗を産む結果となった。なお、SPIE/BACUS Photomask Technology Symposium は9月11日～13日の間、米国カリフォルニア州モントレーのモントレー マリオットホテルにて開催される。

eBeam Initiative の事務局である D2S, Inc.社の CEO Aki Fujimura 氏によると、“20nm 世代以降の先端マスク製造において、パターン形状の複雑化とマスクの高コスト化が急速に進んでいる中、eBeam をベースとした新たな技術は、現実的な描画時間を維持しつつマスク品質とウエハ性能を改善するために必須となっています。我々は eBeam Initiative のメンバーの方々がこのチャレンジに果敢に挑戦していることを嬉しく思います。同時に、BACUS にて発表される数々の先端技術の中から、いくつかをご紹介させていただきます。。 eBeam 技術は、半導体製造のサプライチェーンの中で、さらに磨かれ、さらに価値を上げていくものと期待しております。”

SPIE/BACUS Photomask Technology Symposium 2012 にて、eBeam Initiative のメンバー企業は数々の発表を行います。以下にその一部を抜粋します：

9月11日(火曜日)

- 9:30 am, セッション 3, Patterning – “Improving mask CD uniformity using MB-MDP for 14nm node and beyond,” presented by Samsung Electronics and D2S [8522-04]
- 10:40 am, セッション 3, Patterning – “An enhanced measure of mask quality using separated models,” presented by Samsung Electronics and D2S [8522-06]
- 6:00 – 7:30 pm, ポスターセッション, Mask Data Preparation – “Enhancement of mask process correction (MPC) through dose modulation of already geometrically correct layout data,” presented by SoftJin [8522-77]
- 6:00 – 7:30 pm, ポスターセッション, Metrology – “Photomask quality evaluation using lithography simulation and precision SEM image contour data,” Advantest and D2S [8522-81]
- 6:00 – 7:30 pm, ポスターセッション, Mask Pattern Generators – “Proximity effect correction optimizing image quality and writing time for an electron multi-beam mask writer,” presented by Synopsys and IMS Nanofabrication [8522-87]
- 6:00 – 7:30 pm, ポスターセッション, Mask Pattern Generators – “Evaluation of CP shape correction for e-beam writing,” presented by Advantest and D2S [8522-88]

9月12日(水曜日)

- 2:40 pm, セッション 8, Simulation and Modeling – “Advanced module for model parameter extraction using global optimization and sensitivity analysis for electron-beam proximity effect correction,” presented by Asetla Nanographics, Laboratoire des Technologies de la Microelectronique CNRS and Fraunhofer CNT [8522-37]

9月13日(木曜日)

- 10:40 am, セッション 12, Mask Pattern Generators – “Proposal to extend the loading effect correction in EBM-8000,” presented by NuFlare Technology [8522-51]
- 11:00 am, セッション 12, Mask Pattern Generators – “Printing results of a proof-of-concept 50keV electron multi-beam mask exposure tool (eMET POC),” presented by IMS Nanofabrication [8522-52]
- 11:20 am, セッション 12, Mask Pattern Generators – “Shape-dependent dose margin correction using model-based mask data preparation,” presented by HOYA and D2S [8522-53]

eBeam Initiative メンバー企業による発表のより詳細なリストは eBeam Initiative ウェブサイト

(www.ebeam.org/docs/ebeam_at_bacus_2012.pdf)にてご確認ください。

About The eBeam Initiative

eBeam Initiative は電子ビーム(eBeam)技術を利用した半導体製造に対する新しい手法の普及と促進を目的としたフォーラムです。Initiative のゴールは、半導体業界のエコシステム中で eBeam 技術に対する投資を喚起しつつ、より多くの集積回路(IC)設計を可能とし、より速い商品開発期間(faster time-to-market)を実現する技術の導入を可能ならしめることにあります。e-Beam Initiative はメンバー企業、アドバイザー、およびステアリング委員会から構成され、半導体関連の全分野の機関が参加しており、米 Abeam Technologies、株式会社アドバンテスト、台湾 Alchip Technologies、独 AMTC、米 Applied Materials、米 Artwork Conversion、仏 Aselta Nanographics、米 ケイデンス・デザイン・システムズ、仏 CEA/Leti、米 D2S 社、大日本印刷株式会社、独 EQUlcon Software GmbH Jena 社、株式会社イー・シャトル、米 eSilicon Corporation 社の Jack Harding 氏、米 Fastrack Design 社、独 Fraunhofer CNT、富士通セミコンダクター株式会社、独 GenlSys GmbH 社、米 グローバルフアンドリーズ社、米 Grenon Consulting, HOYA 株式会社、独 IMS CHIPS、奥 IMS Nanofabrication AG 社、日本電子株式会社(JEOL)、米 KLA-Tencor 社、米 Mentor Graphics Corporation、Multibeam Corporation、日本コントロールシステム株式会社、株式会社ニューフレアテクノロジー、米 Petersen Advanced Lithography 社、米 PMC-Sierra 社の Colin Harris 氏、米クアルコム社の Riko Radojcic 氏、韓国サムスン・エレクトロニクス社、印 SoftJin Technologies、仏 STMicroelectronics 社、米 Synopsys 社、米 tau-Metrix 社、米 Tela Innovations 社、TOOL 株式会社、凸版印刷株式会社、独 Vistec Electron Beam Lithography Group、米 Xilinx が含まれます。また、本イニシアティブは、エレクトロニクス業界におけるあらゆる企業および機関に対し、幅広く参加を募っています。URL : www.ebeam.org.

###